

Product Advisory (PA)

件名: RA8 シリーズ面実装パッケージ製品ダイボンド材変更のご案内

発行日: 3/26/2025

出荷開始予定日: 9/1/2025

改版履歴: 初版

変更内容の説明:

対象製品: RA8 シリーズ LQFP-144pin 製品

対象後工程拠点: Renesas Semiconductor (Beijing) Co., Ltd (以下【BJ】)

変更内容: ダイボンド材料を変更します。

変更するダイボンド材料は【BJ】にて量産実績のある材料になります。

対象製品リスト:

別紙 型名一覧表を参照してください。

変更の理由:

安定生産のため。

外形、実装、機能、品質、信頼性への影響:

外形、実装、機能、品質、信頼性への影響はありません。

製品の識別方法:

製品のトレースコードから、弊社生産履歴データの照会が可能です。

信頼性データについて:

信頼性試験は完了しています。添付の補足資料をご参照ください。

サンプル出荷予定日: 非該当

製品/材料の化学物質データ:

弊社営業、販売特約店までお問い合わせをお願い致します。

ご注意:

追加データを含む、この変更通知に関する質問または要求は、発行日から 30 日以内にルネサスに送信する必要があります。

この通知に関するお問い合わせは、弊社営業、特約店までお願い致します。

別紙 型名一覧

NO.	型名	パッケージ 外形	ピン数	ファミリ
1	R7FA8E1AFDCFB#BA0	LFQFP	144	RA
2	R7FA8E1AFDCFB#UA0	LFQFP	144	RA
3	R7FA8M1AFECFB#AA0	LFQFP	144	RA
4	R7FA8M1AFECFB#BA0	LFQFP	144	RA
5	R7FA8M1AFECFB#HA0	LFQFP	144	RA
6	R7FA8M1AHECFB#AA0	LFQFP	144	RA
7	R7FA8M1AHECFB#BA0	LFQFP	144	RA
8	R7FA8M1AHECFB#HA0	LFQFP	144	RA
9	R7FA8T1AFECFB#AA0	LFQFP	144	RA
10	R7FA8T1AFECFB#BA0	LFQFP	144	RA
11	R7FA8T1AFECFB#HA0	LFQFP	144	RA
12	R7FA8T1AHECFB#AA0	LFQFP	144	RA
13	R7FA8T1AHECFB#BA0	LFQFP	144	RA
14	R7FA8T1AHECFB#HA0	LFQFP	144	RA

・補足資料

1. 変更部材の概要

項目		変更前	変更後	備考
組立工程拠点		Renesas Semiconductor (Beijing) Co., Ltd		変更はありません
選別工程拠点				
部材	リードフレーム	-	-	変更はありません
	ダイボンド	A社製ダイボンド材A	B社製ダイボンド材B	下記項目2参照
	モールド樹脂 (レジン材)	-	-	変更はありません
パッケージ	外形図	-	-	変更はありません
捺印	フォント	-	-	変更はありません

2. 変更部材について

部材	変更前	変更後
ダイボンド材	-	同様の部材を使用しています。

※製品機能、特性、信頼性に影響はございません。

3. 4 M変化点（ダイボンド材変更）

検証項目	検証結果	判定
製造装置 Machine	A社製ダイボンド材A及び、B社製ダイボンド材Bのダイマウント工程は、共に同じ製造装置を使用しています。	○
製造方法 Method	A社製ダイボンド材A及び、B社製ダイボンド材Bのダイマウント工程は、共に同じ製造方法です。	○
作業員 Man	作業員認定制度を導入し、教育を受け認定された作業員だけが従事致します。	○
材料 Material	材料認定したダイボンド材を使用致します。 B社製ダイボンド材Bは、量産実績が有り変更について問題ない事を確認致しております。	○

4. 信頼性試験結果

Test Items	Test Conditions	ResultsFailure/Size
High Temperature Operating Life(HTOL)	$T_j=125\text{ }^\circ\text{C}$, V_{ccmax} , 1000 hrs	0/22
High Temperature Storage Life(HTSL)	$T_a=150\text{ }^\circ\text{C}$, 1000 hrs	0/22
Temperature Humidity bias(THB) (*1)	$T_a=85\text{ }^\circ\text{C}$, RH=85 %, V_{ccmax} , 1000 hrs	0/22
Temperature Cycling(TC) (*1)	$T_a=-65\text{ }^\circ\text{C}$ to $150\text{ }^\circ\text{C}$, 300 cycles	0/22
Latch-Up(LU)	Pulse Current Injection, $I=\pm 150\text{ mA}$	0/3
Electrostatic discharge(ESD-HBM)	1.5 k Ω , 100 pF, $\pm 2000\text{ V}$, 1 time	0/3
Electrostatic discharge(ESD-CDM)	$\pm 500\text{ V}$, 1time	0/3
Solderability(SD)	$245\text{ }^\circ\text{C}$, 5 s, Solder coverage $\geq 95\%$	0/5
Resistance to Soldering Heat(PC)	MSL3(Moisture Sensitivity Level 3)	0/22

* 1) THB,TCはMSL3の前処理を実施しています。

・すべてのサンプルについて、製品仕様を満足することを確認するために電気的テストを行っています。

注：部材変更前と同じ評価項目で満足している事を確認しています。